

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2026-006

深圳佰维存储科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保合同总金额	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
广东泰来封测科技有限公司	30,000 万元	130,000 万元 (含本次 10,000 万元续期)	是	否
广东芯成汉奇半导体技术有限公司	10,000 万元	90,000 万元 (不含本次)	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	600,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	248.77
特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资及控股子公司生产经营业务发展需要，公司拟为其提供担保，具体内容如下：

公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订了《综合授信合同》，其中全资子公司广东泰来封测科技有限公司（以下简称“泰来科技”）向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 2 亿元，期限 24 个月。其中 1 亿元为原有授信额度续期，新增授信额度 1 亿元，公司为其提供连带责任保证担保。本次担保无反担保。该笔原有担保事项详见公司于 2024 年 12 月 24 日披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》。控股子公司广东芯成汉奇半导体技术有限公司（以下简称“芯成汉奇”）向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 1 亿元，期限 24 个月，公司为其提供连带责任保证担保，公司提供的担保最高债权额为人民币 1 亿元整。本次担保无反担保。

泰来科技向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请流动资金借款人民币 1 亿元，期限 36 个月。公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《最高额保证合同》，为泰来科技向该行申请的借款提供连带责任保证担保，公司所担保债权之最高本金余额为 1 亿元整。本次担保无反担保。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 12 月 8 日、2025 年 12 月 24 日分别召开第四届董事会第八次会议、2025 年第五次临时股东会并审议通过了《关于 2026 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》，同意为子公司提供不超过 60 亿元人民币（或等值外币）的担保额度，担保额度在有效期内可循环使用。担保期限为自股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度申请综合授信及担保额度预计的公告》。本次担保在公司 2025 年第五次临时股东会授权额度范围内，公司无需另行召开董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	广东泰来封测科技有限公司
被担保人类型及上市公司	全资子公司

持股情况			
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	何瀚		
统一社会信用代码	91441300MA4W3JBE6P		
成立时间	2016 年 12 月 21 日		
注册地	惠州市仲恺区陈江街道侨飞路 25 号		
注册资本	49,300 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	260,107.12	239,420.60
	负债总额	213,100.69	188,177.30
	资产净额	47,006.43	51,243.30

被担保人类型	法人		
被担保人名称	广东芯成汉奇半导体技术有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	公司持股 70%，海南芯成汉奇一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 30%；		
法定代表人	何瀚		
统一社会信用代码	91441900MACXHJEL48		
成立时间	2023 年 9 月 13 日		
注册地	广东省东莞市松山湖园区兴业路 6 号		
注册资本	10,000 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	晶圆级先进封测制造		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	142,569.51	37,915.55
	负债总额	137,626.34	30,451.81
	资产净额	4,943.17	7,463.74

三、担保协议的主要内容

(一) 公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订的《综合授信合同》

- 1、授信人（债权人）：北京银行股份有限公司深圳分行
- 2、申请人（债务人）：广东泰来封测科技有限公司、广东芯成汉奇半导体技术有限公司
- 3、保证人（受信人）：深圳佰维存储科技股份有限公司
- 4、保证方式：连带责任保证
- 5、担保最高债权额：泰来科技人民币2亿元整；芯成汉奇人民币1亿元整
- 6、保证担保范围：泰来科技、芯成汉奇在每一具体业务合同下和《综合授信合同》项下的全部债务向北京银行股份有限公司深圳分行提供连带责任保证担保。
- 7、保证期间：债务履行期届满之日起三年。

(二) 公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订的《最高额保证合同》

- 1、债权人：中国银行股份有限公司深圳南头支行
- 2、债务人：广东泰来封测科技有限公司
- 3、保证人：深圳佰维存储科技股份有限公司
- 4、保证方式：连带责任保证
- 5、担保债权之最高本金余额：人民币1亿元整
- 6、保证担保范围：在《最高额保证合同》第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，以及基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，均属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
- 7、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并向分别要求保证人承担保证责任。

四、担保的必要性和合理性

公司为泰来科技、芯成汉奇提供担保，是为满足泰来科技、芯成汉奇日常经营的资金需求。上述担保有利于增强泰来科技、芯成汉奇融资能力，为其提供相应资金支持，有利于其日常经营稳定，符合公司整体发展战略。

被担保方资产负债率均大于70%，公司对泰来科技、芯成汉奇的经营管理、财务等方面有充分的控制权，能及时掌握其资信状况，违约风险和财务风险在公司可控范围内，公司为其提供担保不会对公司日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，故泰来科技、芯成汉奇未提供反担保。

五、董事会意见

本次担保涉及金额在第四届董事会第八次会议、2025年第五次临时股东会审议批准范围内，无需再次履行审议程序。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 60 亿元（2026 年度担保预计总额），均为公司为合并财务报表范围内的子公司提供的担保，担保总额占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 248.77%。公司对控股子公司提供的担保合同总金额为 27 亿元（含本次担保），担保合同总金额占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 111.95%。公司无逾期和涉及诉讼的对外担保情形。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日